

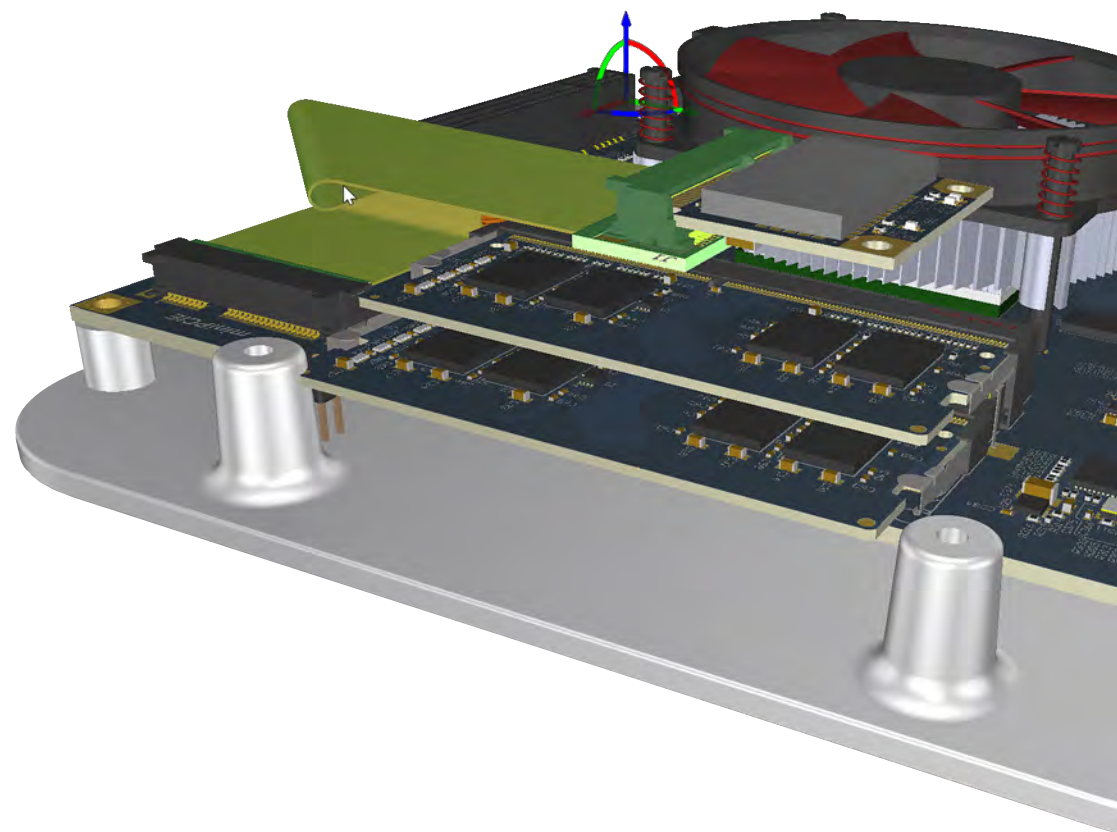
ПРОСТОЙ, СОВРЕМЕННЫЙ И ЕЩЕ БОЛЕЕ МОЩНЫЙ

Компания Altium представляет новую версию своего флагманского продукта Altium Designer 19, в которой наряду с развитием основной концепции решения – мощные и одновременно легкие в применении инструменты – добавлены новые возможности в соответствии с передовыми технологиями проектирования электроники.

Altium Designer 19 – результат значительных улучшений возможностей 3D-моделирования, трассировки и формирования конструкторской документации, конечная цель которых – сделать процесс проектирования электроники более эффективным, производительным и приятным, для всех инженеров и конструкторов печатных плат.

Вы можете визуализировать многомодульные проекты и производить проверки на пересечения за считанные секунды и эффективно создавать надежные многослойные конструкции плат высокой плотности. Поиск и размещение доступных для проекта компонентов больше не обременительны с Altium Designer – мгновенный и точный поиск компонентов в сочетании с непосредственным размещением символов, посадочных мест и 3D-моделей делает проектирование и управление составом изделия увлекательным процессом.

С новейшей версией Altium Designer вы можете использовать передовые технологии благодаря простому и современному интерфейсу самой эффективной из доступных систем проектирования электроники на базе печатных плат.



МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОМОДУЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ С NATIVE 3D™
НОВОВВЕДЕНИЕ
ОПИСАНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Ядро твердотельного моделирования многомодульных конструкций NATIVE 3D™

Собственное моделирование многомодульных сборок с твердыми телами, а не поверхностями.

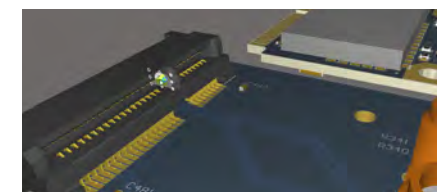
Невероятная производительность работы и визуализации по сравнению с предыдущей версией, а также новые возможности (см. ниже).



Интеллектуальные сопряжения объектов

Настоящая связь объектов в трех измерениях, которая остается постоянной.

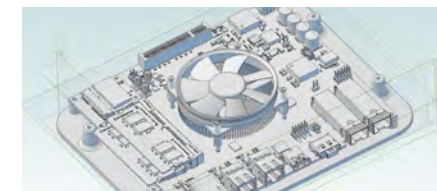
Быстрое выравнивание объектов и плат друг с другом и другими 3D-объектами в сборке и их совместное перемещение. Значительно быстрее и интуитивно понятнее.



Экспорт многомодульной конструкции в MCAD-системы

Полный импорт и экспорт моделей в форматах STEP и Parasolid.

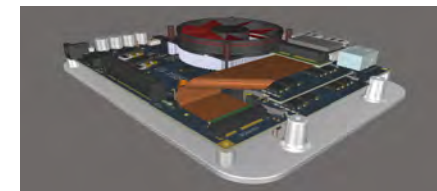
Всю сборку можно смоделировать и проверить на пересечения в Altium Designer перед экспортом в MCAD-систему.



Моделирование гибко-жестких плат в многомодульной конструкции

Редактор многомодульных сборок теперь поддерживает гибкие и полностью согнутые гибко-жесткие платы.

Точное размещение гибких межсоединений в сложном состоянии обеспечивает собираемость и управление сигналами.



НОВОВВЕДЕНИЕ

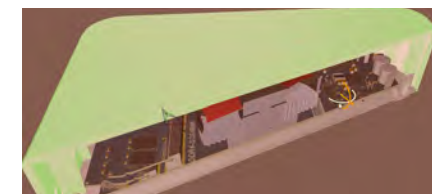
ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Разрезы под любым углом

Разрезы не ограничены только существующими плоскостями XY, XZ и YZ.

Разрез сборки Multi-Board любой заданной пользователем плоскостью, с улучшенной твердотельной визуализацией.



БЫСТРОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТРАСС

НОВОВВЕДЕНИЕ

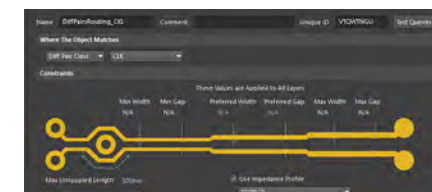
ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Управление импедансом одиночных цепей и дифференциальных пар

Рассчитанные профили импеданса из менеджера структуры слоев доступны при трассировке и в правилах проектирования.

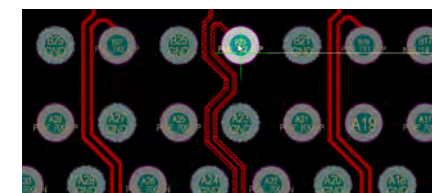
Ускоренная настройка правил для быстродействующей трассировки с управляемым импедансом и автоматическое применение ширины и зазора при трассировке одиночных цепей и дифференциальных пар.



Сглаживание, контроль взаимосвязи на всем пути дифференциальной пары, входы в контактные площадки

Улучшенное качество геометрии трасс, в том числе при расталкивании.

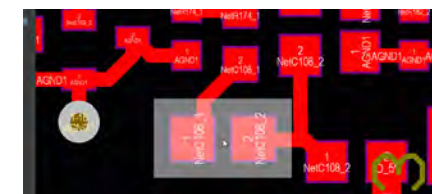
Значительная экономия времени на улучшение геометрии трасс. Более высокое качество изначальной трассировки. Повторная трассировка создает качественный результат с первого раза.



Автоматическая перетрассировка при перемещении компонента

Перемещение компонента с подсоединенными трассами позволяет проводить повторную трассировку и сглаживание, без разрыва соединений.

Поддержка высококачественных сглаженных входов в контактные площадки и соединений при изменении положения компонента для экономии времени.



ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ СЛОЕВ И ИМПЕДАНСОМ

НОВОВВЕДЕНИЕ

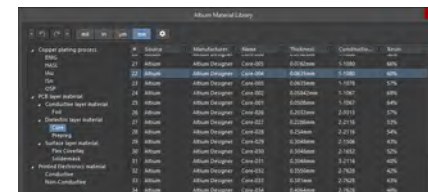
ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Библиотека материалов

Библиотеку проводящих и изолирующих материалов можно создать, сохранить и импортировать.

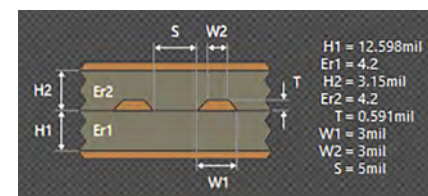
Точное задание структуры слоев и расчет профилей трасс с контролируемым импедансом с помощью данных о материалах.



Создание профилей импеданса

Расчет импеданса одиночных цепей и дифференциальных пар с использованием точного модуля анализа.

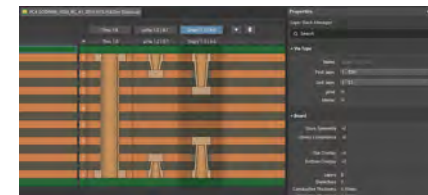
Ширину трасс и зазоры можно определить для целевого импеданса. Интерактивной трассировкой легко управлять для автоматического выбора правильной ширины и зазоров.



Микропереходы, переходы через слой, обратное высверливание (Fearless HDI™)

Ясное определение и визуализация в структуре платы микропереходов, переходов через слой и обратного высверливания.

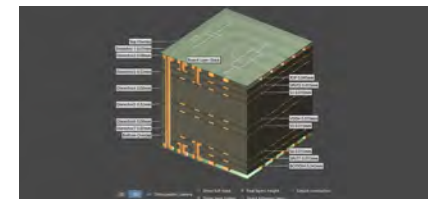
Точное задание HDI-плат и мгновенный визуальный отклик в процессе настройки структуры слоев и трассировки для рассеяния сомнений о технологичности проекта.



Трехмерная визуализация структуры слоев

Визуальное 2D- и 3D-представление структуры слоев и переходов, в масштабе или без него.

Ясное представление и визуальный отклик в процессе настройки структуры слоев для рассеяния всех сомнений касательно ламинации, металлизации и сверления.



НОВОВВЕДЕНИЕ

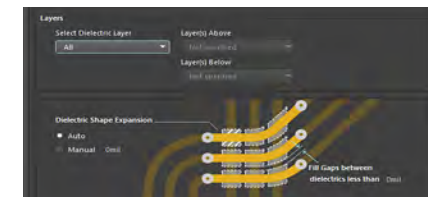
Технология проводящих чернил

ОПИСАНИЕ

Аддитивные технологии печатной электроники с использованием проводящих и изоляционных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Конструирование и трассировка печатных цепей с автоматическим формированием множества проводящих и изолирующих слоев для современного прототипирования и соединения компонентов.



МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОПЕРЕХОДОВ И МЕЖСОЕДИНЕНИЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

НОВОВВЕДЕНИЕ

Определение и размещение микропереходов и переходов через слои

ОПИСАНИЕ

Определение HDI-структур: микропереходов, переходов через слои и многоуровневых микропереходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

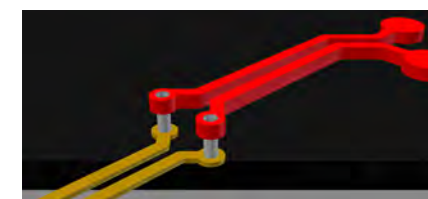
Точное конструирование HDI с микропереходами, переходами на контактных площадках и лазерным высверливанием, обеспечивающее надежность и ясное документирование для производства.



Интерактивная визуализация HDI

Визуальное 2D- и 3D-представление всех структур переходов.

Интерактивный 2D- и 3D-просмотр заданных и размещенных микропереходов, переходов с пропуском слоя и многоуровневых структур для визуального контроля технологичности конструкции.



ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОИСК, РАЗМЕЩЕНИЕ И СОЗДАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

НОВОВВЕДЕНИЕ

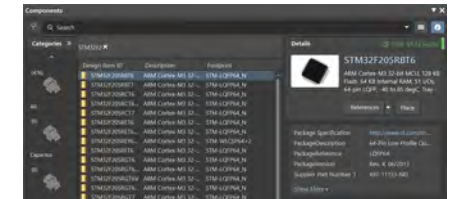
ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Центральная панель компонентов

Панель Components для поиска и размещения компонентов из любой библиотеки.

Единая панель компонентов для быстрого поиска по всем компонентам в библиотеках независимо от типа используемых библиотек с возможностью размещения найденных компонентов непосредственно на схеме или на плате.



Прямой поиск и размещение компонентов

Мгновенный поиск по компонентам и моделям.

Невероятно быстрый поиск компонентов позволяет проводить фильтрацию результатов по типу, корпусу, величинам или параметрам, что помогает находить требуемые компоненты, когда это необходимо, не выходя из среды проектирования.



Единый редактор компонентов

Новый единый редактор компонентов объединяет символ, посадочное место, расчеты и цепочку поставок.

Новый центральный редактор компонентов позволяет искать и повторно использовать символы, посадочные места, цепочки поставок и параметры из Ostorpart, включает в себя мощный мастер создания символов, мастер формирования IPC-совместимых посадочных мест и автоматический поиск компонентов.



УЛУЧШЕННОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

НОВОВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Редактор Draftsman®

Непосредственное размещение всех необходимых видов для сборки и изготовления с прямой связью с источником данных для простого обновления чертежа.

Устранение необходимости в дополнительных программных средствах и в разрозненных рабочих процессах для формирования сборочных и производственных чертежей.

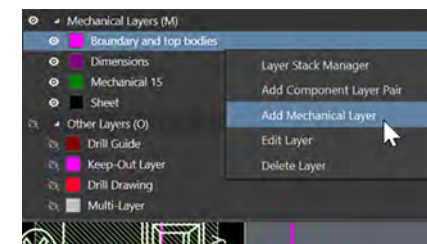
Обновление всех чертежей по нажатию кнопки, без необходимости в передаче файлов.



Неограниченные механические слои

Конструкторы могут добавлять чертежи, примечания и прочие данные на механические слои, без ограничения их числа.

Не имеет значения, насколько сложным становится проект или какими могут быть уникальные требования каждого заказчика, поскольку теперь можно добавлять любое количество дополнительных неэлектрических слоев для любых целей – внесение примечаний, добавление таблиц, документирование, черчение и т.д.



ОПТИМИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВОМ ИЗДЕЛИЯ И ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК

НОВОВВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ActiveBOM®

Ссылки на физические компоненты в составе изделия позволяют связать каждую деталь проекта с актуальной информацией о доступности, цене и цепочке поставок от более 100 проверенных поставщиков или от собственных поставщиков.

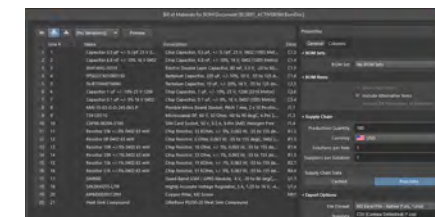
Простое отслеживание доступности, цены, времени поставки из проверенных источников данных на ранней стадии проектирования, что позволяет оставить решения о приобретении компонентов на финальные этапы. Легкое размещение компонентов в проекте и их актуальная связь с физическими компонентами от поставщиков.



Экспорт в нейтральную электронную таблицу

Отчеты о составе изделия можно сформировать и экспортировать в любой из форматов CSV, XML, XLS.

Для экспорта отчета из Altium Designer 19 не требуется Microsoft Excel. Предыдущие версии полагались на установленный Excel, что сокращало доступные варианты формирования выходной документации. Теперь любые отчеты о составе изделия можно сформировать как при наличии, так и при отсутствии Excel.



Все лицензии Altium Designer включают в себя один год подписки Altium Subscription с доступом к Altium 365 – облачной платформе, обеспечивающей удобное сотрудничество инженеров при проектировании электроники. Altium 365 предоставляет бесшовный доступ из Altium Designer или веб-браузера к единой среде взаимодействия проектировщиков различных специальностей для синхронизации данных, получения актуальной информации и обеспечения технологичности продуктов. Благодаря активной подписке вы также получаете доступ к новейшим версиям и обновлениям Altium Designer сразу после их выхода.

О КОМПАНИИ ALTIUM

Altium LLC (ASX:ALU) является международной корпорацией-разработчиком ПО, штаб-квартира расположена в городе Сан-Диего, штат Калифорния, США. Приоритетными направлениями корпорации являются системы для 3D-проектирования печатных плат и разработки встроенных систем. Продукты Altium находят применение по всему миру, как на ведущих проектных предприятиях, так и в рядовых сообществах проектирования электроники.

Уникальные решения Altium позволяют организациям и проектным сообществам взаимодействовать между собой, создавать и улучшать интегрированные изделия, оставаясь в рамках запланированных бюджетов и сроков. Предлагаемые продукты: ACTIVEBOM®, ActiveRoute®, Altium Designer®, Altium 365®, Altium Vault®, Altium NEXUS™, Autotrax®, Camtastic®, Ciiva™, Ciiva SMARTPARTS®, CircuitMaker®, CircuitStudio®, Codemaker™, Common Parts Library™, Draftsman®, DXF™, Easytrax®, EE Concierge™, NanoBoard®, NATIVE 3D™, OCTOMYZE®, Octopart®, P-CAD®, PCBWORKS®, PDN Analyzer™, Protel®, Situs®, SmartParts™, ряд компиляторов встроенного программного обеспечения TASKING® и Upverter™.

Компания Altium, основанная в 1985 году, имеет офисы по всему миру, в городах Сан-Диего, Бостон и Нью-Йорк в США, в городах Карлсруэ, Америксфорт, Киев, Мюнхен, Маркело и Цуг в Европе, в городах Шанхай, Токио и Сидней Азиатско-Тихоокеанского региона. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.altium.com. Вы также можете следить за событиями компании Altium через Facebook, Twitter, LinkedIn и YouTube.